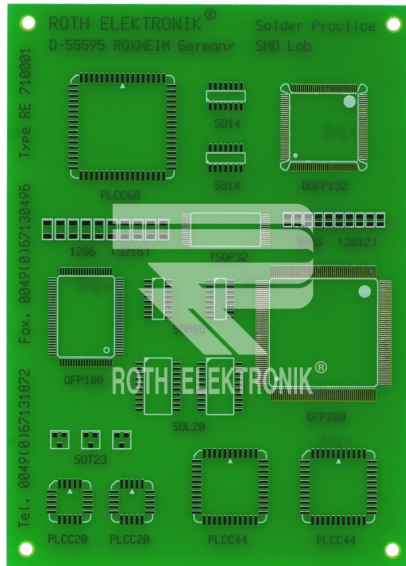


TSSOP-SMD Multiadaptador (thin shrink small outline package)



RE710001-LF



- epóxido FR4, 1,50 mm, por un lado 35 µm CU
- lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree), máscara de inhibición de soldadura e impresión de dotación.
- placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura SMD estándar y "fine pitch"
- adecuada también para la dotación automática (pick and place)
- tamaño: 100 x 140 mm
- 38 componentes SMD distintos:

PLCC:	2x20, 2x44, 68
QFP:	100 rect., 132 sq., 208 sq.
TSOP 32:	1x
SOT 23:	3x
SO 14:	2x
SOM 16:	2x
SOL 20:	2x
0805 Chip condens:	10x
1206 Chip condens:	10x